

第34回マイクロエレクトロニクスシンポジウム2024



大同大学

開催日・講演発表日：2024年9月11日(水)～13日(金)

開催会場：大同大学（名古屋市） & オンライン開催

交流会：9月12日(木) ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 先着140名

《MES2024ホームページ》 * 詳細および最新の情報はこちらからご参照ください

<https://jiep.or.jp/event/mes/mes2024/index.php>

◆特別講演◆ 9月12日(木)15:10～17:20

1. 「企業経営と大学経営 双方に携わって思うこと」 武藤 大 氏 (学校法人大同学園 理事長)

2019年に本学園の理事長に就任しましたが、前職は鉄鋼会社に37年間勤務していました。

縁あって学校法人の経営を任せられ、企業経営と学校経営とで違いを感じることや、企業と大学の連携に関して思うことが多々あります。

講演では、大同特殊鋼グループの事業と本学会にご参加の皆さまにも身近な製品をいくつかご紹介し、学園の歴史や建学の精神をお話いたします。また、企業経営と大学経営との双方に携わってみて考えていることから、研究マネジメントに対する考え方や取り組みスタンスの違いと、ますます早期化している就職（採用）活動と学事日程のずれ違い、それらから大学と企業が一体となって取り組むべきと考えている事についてお話したいと思います。



2. 「三菱電機のパワーモジュールの技術動向」 別芝 範之 氏 (三菱電機株式会社 コンポーネント製造技術センターパワーデバイス・モジュール技術推進部 部長)

三菱電機では、重点成長事業の一つとしてパワーデバイス事業の強化に取り組んでいます。当社はパワーデバイス・パワーモジュールおよびこれらを搭載した応用製品を一貫して手掛けており、様々な分野で活用いただいております。今回の発表では、パワーモジュールのアセンブリ技術について、学会や当社の三菱電機技報で報告した内容を元に最新の動向について説明させていただきます。

特別セッション 9月11日(水)13:00～17:10 予定

◆特別企画セッション：4講演

長谷川 将司 氏 (クオルテック), 鈴木 智之 氏 (東芝), 上乃 聖 氏 (名古屋工業大学), 白松 俊 氏 (名古屋工業大学)

◆未来をつくれ！若手技術者の大活躍推進セッション：3講演・若手講演5件・パネルディスカッション 予定

・「未来を先送りしない」 益 一哉 氏 (東京工業大学 学長)

・「若手と女性技術者がエレクトロニクス業界で輝くために」 須永 順子 氏 ((一社) 情報社会デザイン協会 理事)

・「前工程と後工程の垣根を超えて～裏面照射型CMOSイメージセンサ開発秘話～」

大岸 裕子 氏 (ソーセミコンダクタソリューションズ(株)統括課長)

◆ロードマップセッション：JEITA ①「注目される市場と電子機器群」②「電子デバイスパッケージ」 尾崎 裕司 氏(ナミックス(株))

部品内蔵「部品内蔵技術ロードマップ2022年度版概要」 松澤 浩彦 氏 (株)図研)

◆電子デバイス実装研究委員会 共催 (スマートプロセスエレクトロニクス生産部会) ～エレクトロニクスにおける検査と分析～

・「X線位相イメージング・位相CTによる高感度非破壊検査」 百生 敦 氏 (東北大学)

・「チップレットの高精細・高速 CT 型X線検査技術 (仮)」 笠原 啓雅 氏 (オムロン株式会社)

・「部品内部の水と径元素の放射光X線分析技術-燃料電池とリチウムイオン電池において-」 磯村 典武 氏 ((株)豊田中央研究所)

・「パルスNMRによる粉体の濡れ性および濃厚分散体の評価」 池田 純子 氏 (マジエリカ・ジャパン(株))

・「ソルダリング接合部の自動視覚検査 (未確定)」 (検討中)

マイクロエレクトロニクスシンポジウム2024 (MES2024)

一般口頭発表：62件

- 1) 先端プロセス・実装技術：6件
- 2) パワーエレクトロニクス実装技術：6件
- 3) 高速高周波実装・電磁特性技術：3件
- 4) マイクロメカトロニクス実装技術：3件
- 5) 光回路実装技術：2件
- 6) プリントブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス：6件
- 7) 環境調和型エレクトロニクス：6件
- 8) 信頼性技術：18件
- 9) シミュレーション・計算機による評価・設計：3件
- 10) めっき技術：3件
- 11) 最先端材料：6件

依頼講演：5件

9月13日(金)10:00~10:40・13:00~13:40

- ・「周期構造を有する伝送線路によるクロストーク抑制技術のインターポーザへの適用検討」
大島 大輔 氏 (日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所 セミコンダクター)
- ・「コンデンサ内蔵基板を使った次世代High Performance Computing(HPC)向けDC-DCコンバータモジュール」
糸山 寿毅 氏 (株)村田製作所技術・事業開発本部事業インキュベーションセンター)
- ・「車載電子部品の品質確保の取組み」
西森 久雄 氏 (トヨタ自動車(株)デジタルソフト開発センター)
- ・「ナノカーボン材料に基づくフレキシブルエレクトロニクス」
大野 雄高 氏 (名古屋大学未来材料・システム研究所教授)
- ・「CPO適用に向けたポリマー光導波路型結合素子」
木下 遼太 氏 (住友ベークライト(株)光回路事業開発部主査)

ポスター発表：14件

ショートプレゼンテーション：9月12日(木)11:20~12:00

ポスター展示コアセッション：9月12日(木)13:00~14:20

① 関西大学大学院

② ウシオ電機(株)

③ 東北大学

④ 田中貴金属工業(株)

⑤ 大阪大学

⑥ 国研 産業技術総合研究所

⑦ 田中貴金属工業(株)

⑧ (株)レゾナック

⑨ 公立諏訪東京理科大学

⑩ 産業技術総合研究所

⑪ 法政大学

⑫ 法政大学

⑬ ウシオ電機(株)

⑭ 東京工芸大学大学院

企業展示：18社

企業プレゼンテーション(7社)：9月12日(木)10:00~11:10

企業展示 コアセッション：9月12日(木)13:00~14:20

9月13日(金)11:50~13:00

ソニーセミコンダクタ
ソリューションズ(株)

SONY
Sony Semiconductor Solutions Corp.

奥野製薬工業(株)

OKUNO
OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.

シーメンス(株)

SIEMENS

(株)スフィンクス・
テクノロジーズ

S-FINX
Technologies

(株)図研

ZUKEN
The Partner For Success

JCU(株)

JCU

(株)サーモグラフィティクス

COMPOROID サーマグラフィティクス
170Wmm Graphite Composite

住友金属鉱山(株)

メルテックス(株)

Meltex
Link to X

(株)野田スクリーン

株式会社 野田スクリーン

ティー・エイ・インストゥルメント
・ジャパン(株)

Waters | **TA**
Instruments

サンユレック(株)

SANYU REC

(株)先端力学シミュレーション研究所

A&TOM R&D

オムロン(株)

OMRON

タカヤ(株)

TAKAYA

Patentix(株)

PATENTIX

マジエリカ・ジャパン(株)

Mageleka

レーザーテック(株)

Lasertec

参加費
税込み

正会員・賛助会員・共催学会員17,000円、協賛学会員22,000円、非会員30,000円
学生会員・共催学生会員4,000円、協賛学生会員5,000円、非会員学生6,000円 (学生は交流会参加費込)
オプション：交流会参加(先着140名)6,000円、冊子版論文集3,000円

【協賛団体】予定

IEEE EPS Japan Chapter, 映像情報メディア学会, 応用物理学会, 化学工学会, 関西サイエンス・フォーラム, KEC関西電子工業振興センター, 高分子学会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電子情報技術産業協会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本電子回路工業会, 日本電子材料技術協会, 日本ロボット工業会, 光産業技術振興協会, 表面技術協会, 溶接学会, 粉体粉末冶金協会

主催：一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2

お問合せMail：E-mail: mes2024@jiep.or.jp

ホームページ：<https://jiep.or.jp>



共催

Manufacturing Science Technology エレクトロニクス生産科学会 スマートプロセス学会